

第88回レーザー加工学会講演会 平成29年10月12日(木) 大阪大学 銀杏会館

ホール		ホール	
10:30	開会の辞	石出 孝 (三菱重工(株))	
10:35	ポスターショートプレゼンテーション(ホール) + ポスタープレゼンテーション(会議室C)	(会議室C)	
	ポスター発表	ポスター展示	カタログ展示
	青色半導体レーザーを用いた選択的レーザー溶融法による純銅の造形 原 隆裕(大阪大学)	(株)プロフィット	(株)ノビテック
	スパッタレスレーザー金属積層造形を用いた純チタンの積層造形と金属組織の評価 西 貴哉(近畿大学)	(株)ノビテック	
	下地膜を利用した銅マイクロ粒子レーザー焼結法による石英ガラス基板への配線形成 福島 想人(茨城大学)	(株)ワイ・イー・データ	
	レーザー焼結法を用いたジルコニア系マイクロ固体酸化物形燃料電池用空気極膜の作製と評価 吉田 修一朗(茨城大学)	レーザーライン(株)	
	二光子還元によるハイドロゲル内部への金属構造作製とその可変光学特性 町田 菜南(慶應義塾大学)	NED次世代レーザープロジェクト	
	フェムト秒レーザー照射によるハイドロゲル内部への導電性構造の作製 植村 俊彦(慶應義塾大学)		
	Cu <sub>2</sub> Oナノ粒子還元を利用した導電性Cu微細パターンの直接描画 近藤 幸成(名古屋大学)		
	レーザー照射とめっきによるガラス基板へのマスクレス配線形成 水戸岡 豊(岡山県工業技術センター)		
	LEDアレイ顕微鏡を用いたガラス内部構造変化のマルチコントラスト像の取得 杉本 凌(立命館大学)		
	アキシコンレンズを用いたガラス内部への屈折率変化の誘起 寺井 誠也(立命館大学)		
	ナノ秒レーザーを用いたCFRPのアブレーション加工とHAZの評価 梶井 省吾(大阪大学)		
	フェムト秒レーザーを用いたガラスと銅の接合における銅表面粗さの検討 松吉 聡志(立命館大学)		
	中間材を用いたアルミニウム薄板/CFRPのレーザー接合技術 阿久津 真広(茨城大学)		
臨時総会(11:30~12:00)			
昼食休憩(12:00~13:00)			
ホール		ホール	
プレナリーセッション		Chair :	
13:00	【基調講演1】「マイクロチップレーザー」(仮題)	平等 拓範 (自然科学研究機構)	
Coffee break(13:50~14:00)			
ホール		大会議室	
12A1: 現象観察・解明・シミュレーションなど		12B1: 表面エンジニアリング	
Chair :山本 元道(広島大学)		Chair: 岡本 康寛 (岡山大学)	
14:00	レーザー溶接における熱と物質の輸送	14:00	Fabrication of bionic surfaces with mixed superhydrophobic and superhydrophilic properties using fs-lasers
川人 洋介(大阪大学)		Victor Matyilitsky (Spectra-Physics)	
14:30	ホットワイヤ・レーザー溶接法を用いた高張力鋼板重ねすみ肉溶接時の適正条件の導出	14:30	環境にやさしいレーザー洗浄技術
門 格史(広島県立総合技術研究所)		西原 啓三(東成エレクトロビーム(株))	
15:00	Inline Coherent Imaging: Multi-factor Imaging of Industrial Laser Processes	15:00	レーザーマイクロジェットによるSiC材の加工とアプリケーション
Paul Webster (Laser Depth Dynamics Inc)		金 赫((株)牧野フライス製作所)	
15:30	2次元センサーを用いた2色法によるレーザー溶接の温度分布計測	15:30	整形フェムト秒ベッセルビームによるSi貫通穴加工
臼井 寛之((株)ノビテック)		杉岡 幸次(理化学研究所)	
1日目終了			
16:00		懇親会(16:30~18:30) ポスター発表 優秀賞発表	

時間・内容に、一部変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

第88回レーザー加工学会講演会 平成29年10月13日(金) 大阪大学 銀杏会館

ホール		大会議室	
13A1:IoT	Chair: 門屋 輝慶 (LTF)	13B1:付加加工	Chair: 塚本 雅裕 (大阪大学)
9:30 IoT(仮題)	森 彰(産業技術総合研究所)	9:30 DMGMORIのAdditive Manufacturingの取り組みについて(仮題)	小田 陽平 (DMG森精機(株))
10:00 アマダのIoT「V-factory」の仕組みと市場展開の目的	横山 匡((株)アマダ)	10:00 直噴型レーザーコーティング技術の工作機械への応用	浅野 孝平(ヤマザキマザック(株))
10:30 Latest trends of IoT and Industry 4.0 in laser technology	Bastian Becker (Trumpf)	10:30 レーザクラディングによる次世代高速鉄道用ブレーキディスクの開発	松井 祥司 (大阪富士工業(株))
		11:00 高輝度青色半導体レーザー搭載溶接機および積層造形装置の開発(仮題)	升野 振一郎(大阪大学)
11:00	<b>昼食休憩 (11:00~12:30)</b>	11:30	<b>昼食休憩 (11:30~12:30)</b>
<b>第89回講演会実行委員会 (11:40~12:20)</b>			
プレナリーセッション		Chair :	
12:30	【基調講演2】 フォトニック結晶レーザー (仮題)	野田 進 (京都大学)	
ホール		大会議室	
13A2: 鉄鋼・重工分野のレーザー加工	Chair: 木谷 靖 (JFEスチール(株))	13B2: 微細加工用レーザー光源及びビームデリバリとそれらの新展開	Chair: 江畑 恵司(住友電気工業(株))
13:20 レーザ・アークハイブリッド溶接低温割れ試験と力学的指標の検討	猪瀬 幸太郎((株)IHI)	13:20 光渦レーザー加工	尾松 孝茂(千葉大学)
13:50 レーザ溶接におけるシームトラッキングシステムと継手ギャップの適応制御の研究	鳥越 功(前田工業(株))	13:50 光渦レーザーによる磁性体ナノ構造の超高速制御法についての理論的提案	佐藤 正寛(茨城大学)
14:20 レーザクラディングプロセス技術の開発および装置導入	石川 毅(住友重機械ハイマテックス(株))	14:20 ビーム整形されたフェムト秒レーザーによる生体細胞のナノサージェリー	長谷川 智士(宇都宮大学)
14:50 高出力レーザー溶接による鋼管製造技術	木谷 靖 (JFEスチール(株))	14:50 常温接合を用いた高性能固体レーザーおよび波長変換デバイスの開発	庄司 一郎(中央大学)
<b>Coffee break (15:20~15:30)</b>			
会議室1(予定)		大会議室	
13A3 :レーザー加工技術開発と産業応用	Chair: 三瓶 和久 ((株)タマリ工業)	13B3: 精密微細レーザー加工(超短パルスレーザー加工を含む)	Chair: 福満 憲志(浜松ホトニクス(株))
15:30 【特別講演】 Recent Developments in Laser Processing at TWI	Paola De Bono (TWI Ltd)	15:30 化学修飾による木材への機能性付与を目的としたレーザーマイクロインサイジング	福田 聡史(あいち産業科学技術総合センター)
16:10 レーザ加工機の先端技術と最新製品の市場動向調査報告	家久 信明(フォトンブレインジャパン)	16:00 フェムト秒ダブルパルスによる単結晶SiCの低ダメージ加工	林 照剛(九州大学)
16:40 二次電池製造におけるレーザー溶接技術の開発～高品質なAl合金溶接を目指して～	齋藤 茂樹(プライムアースEVエナジー(株))	16:30 ピコ秒レーザーを使ったガラスの分離	中谷 郁祥(三星ダイヤモンド工業(株))
17:10 Znめっき鋼板のレーザー重ね溶接技術の開発	樽井 大志 (日産自動車(株))	17:00 20 fs パルスビームアレイ生成のためのカスケード光学系	中野 秀俊(東洋大学)
		17:30 ステルスダイシング技術の最新動向	鈴木 那津輝(浜松ホトニクス(株))
17:40	<b>終了</b>	18:00	<b>終了</b>

時間・内容に、一部変更が生じる場合がありますのでご了承ください。